# 掺杂金刚石薄膜的缺陷研究\*

胡晓君<sup>1</sup>)<sup>†</sup> 李荣斌<sup>1</sup>) 沈荷生<sup>1</sup>) 何贤 $\mu$ <sup>1</sup>) 邓 文<sup>2</sup>) 罗里熊<sup>2</sup>)

(上海交通大学金属基复合材料国家重点实验室,上海 200030)

<sup>2</sup>(广西大学物理系,南宁 530004) (2003年6月13日收到,2003年9月24日收到修改稿)

利用多普勒增宽谱和电子顺磁共振研究了掺硼和掺硫金刚石薄膜的缺陷状态.多普勒增宽谱的结果表明,不同杂质元素掺杂的金刚石薄膜,其中使正电子湮没的缺陷种类是相同的;正电子与不同杂质元素硼、硫之间的相互作用不明显;少量硼可使金刚石膜中的空位浓度减少.EPR结果表明,各掺杂样品的顺磁信号主要来自于金刚石的碳悬键.

关键词:金刚石,掺杂,多普勒增宽谱,电子顺磁共振 PACC:8120V,6170T,7870B,6116N

## 1.引 言

正电子是固体中空位、位错、晶界与相界等缺陷 的灵敏探针<sup>[1]</sup>,因此正电子湮没谱方法是研究材料 微观缺陷的有效手段.正电子湮没实验技术主要包 括寿命测量,角关联测量和多普勒增宽谱测量.多普 勒增宽谱测量给出的信息等效于从角分布中得到的 信息,虽然其动量分辨率较差,但它是一种比较简单 的单探头系统,可以通过符合道分配技术或能量相 近的γ射线来连续地监视仪器;并且它的数据积累 速度高,因而完全能弥补动量分辨率低的缺点<sup>[2]</sup>.多 普勒增宽谱的两个主要参数是形参数*S* 和翼参数 *W*,它们分别指价电子动量分布和核电子动量分布.

近年来,正电子湮没技术广泛应用于金刚石薄膜的研究中.Dannefear等人<sup>[3]</sup>发现金刚石中单空位的正电子寿命为152ps,双空位为184ps.他们用正电子湮没技术研究了各种条件下得到的CVD金刚石膜,发现各种膜中都含有单空位、双空位和空位团簇,并且这些空位的分布很不均匀,有的膜中空位含量少,而有的膜中空位含量很高<sup>[4]</sup>.另外,结合不同空位类型的PL谱线和正电子湮没的结果,得到了单空位的PL谱线在1.68eV处有一尖峰,双空位在1.83eV有一宽带中心,空位团簇在1.72eV处有

峰<sup>[4]</sup>.目前,利用正电子湮没技术研究掺杂金刚石膜中的缺陷等问题的报道还较少,已有的结果主要集中在金刚石中的氮杂质方面,发现空位容易与氮杂质形成 N-V 复合体,从而影响正电子的湮没<sup>[5]</sup>,但氮杂质本身与正电子并没有强烈的相互作用<sup>[6]</sup>.另外,对掺硼金刚石膜中缺陷的正电子湮没研究表明<sup>[4]</sup>,硼浓度为 10<sup>20</sup> cm<sup>-3</sup>时,可以显著减小金刚石膜中的空位含量.

电子顺磁共振(EPR)可用于研究固体中杂质和 点缺陷的局域电子态,确定晶体的局部对称性,分析 电子与核的耦合等<sup>[7]</sup>,也是研究金刚石薄膜中缺陷 状态的有效方法<sup>[8]</sup>.

本文将利用多普勒增宽谱研究不同元素掺杂的 金刚石薄膜的正电子湮没特性,并结合 EPR 实验分 析掺杂金刚石薄膜中的缺陷状态。

### 2. 试验方法

利用微波 CVD 方法在 p 型单晶硅衬底上制备 掺硫和掺硼金刚石薄膜,主要工艺参数为 微波功率 为 900W,衬底温度为 550—600℃,气体压力为 3— 6kPa.采用化学纯的固体 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 和硫粉作为硼源和硫 源.掺硼时直接将固体 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 放入反应室中的样品台 上,掺硫时将硫粉溶解在苯中,通过 H, 鼓泡带入反

<sup>\*</sup> 国家自然科学基金(批准号 50082005)资助的课题.

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> E-mail :huyezi@163.net ;电话 1021-62933163.

应室 样品的其他特征见表 1.用 University of Trento 研制的慢束单能正电子谱仪对掺硼、掺硫及未掺杂 的金刚石薄膜进行多普勒增宽谱测量,测量了常温 下形参数 *S* 和翼参数 *W* 与正电子入射能量和入射 深度的关系,以及 *S* 与 *W* 的关系曲线.用 Bruker EMX-EPR 谱仪测量了常温下各样品的 EPR 谱线.

表1 各样品的基本参数

| 样品编号 | 样品特征     | 碳源 | 电阻率/Ω·cm | 厚度/µm |
|------|----------|----|----------|-------|
| 1    | 未掺杂金刚石薄膜 | 苯  |          | 2     |
| 2    | 掺硼金刚石薄膜  | 丙酮 | 40       | 6     |
| 3    | 掺硼金刚石薄膜  | 丙酮 | 100      | 3     |
| 4    | 掺硫金刚石薄膜  | 苯  |          | 4     |

### 3. 结果与讨论

在多普勒增宽谱的测试中,计算形参数 S 和翼 参数 W 时,由于不同的实验室采用的能量边界不 同 ,得到的参数值也不相同.一般情况下,正电子同 行将 S 参数和 W 参数与单晶 Si 样品基体中的 S 和 W 参数相比,得到  $S_n$  和  $W_n$  参数.在相同的实验条 件下,单晶 Si 样品基体中的 S 和 W 参数为:

#### S(Si) = 0.5216, W(Si) = 0.17958

根据  $S_n = S/S(S_i)$ ,和  $W_n = W/W(S_i)$ ,可算出样品 的  $S_n$  和  $W_n$  参数,其与正电子注入能量的关系如图 1 所示.图 2 为各样品的  $S_n$  和  $W_n$  参数与正电子注 入深度的关系.各样品的 S-W 关系曲线如图 3 所 示,图 4 为各样品在正电子注入能量为 4keV 和 8keV 时的 S-W 值连线.

EPR 谱的分析包括 g 因子、线宽和线形等,各 参数的定义可参看文献 9].测量得到的各样品的 g 因子和线宽如表 2 所示.

在多普勒增宽谱测量中,*S* 值大对应缺陷密度 高,*S* 值小对应缺陷密度低<sup>10]</sup>.从图1看,掺硫金刚 石膜的缺陷密度比未掺杂金刚石膜的高,掺硼金刚 石膜的缺陷密度比掺硫膜和未掺杂膜的低.对于硼 掺杂金刚石膜来说,我们的结果与文献中的结果一



图 1 各样品的 S<sub>n</sub> 和 W<sub>n</sub> 参数与正电子注入能量的关系



图 2 各样品的 S<sub>n</sub>(a)和 W<sub>n</sub>(b)参数与正电子注入深度的关系



图 3 各样品的 S-W 曲线



2016

图 4 各样品在正电子注入能量为 4keV 和 8keV 时的 S-W 值连线

| 样品号 | g      | $\Delta H_{\rm pp}/10^{-4}{\rm T}$ |
|-----|--------|------------------------------------|
| 1   | 2.0029 | 4.1                                |
| 3   | 2.0027 | 3.23                               |
| 4   | 2.0025 | 4.5                                |

表 2 各掺杂样品的 g 因子和  $\Delta H_m$  值

致.如 Dannefear 等人<sup>[3]</sup>发现硼掺杂(硼浓度为 10<sup>20</sup>/ cm<sup>3</sup>)可以极大地减少金刚石膜中的空位含量. Show<sup>[11]</sup>用电子自旋共振研究了热丝 CVD 方法制备 的掺硼金刚石膜中硼原子产生的缺陷结构,观察到 在 CVD 过程中引入硼原子可以减少顺磁缺陷(*P*<sub>da</sub> 和 P<sub>ac</sub>心),因为硼的引入降低了缺陷消失所需的激 活势垒.另外,高浓度的硼含量可能减小空位的含 量<sup>[4]</sup>,但这并不是说,金刚石膜中硼杂质浓度越高, 其测得的 S 值就会越小.从图 1 可知,低掺杂即电 阻率高的掺硼膜中的缺陷密度比高掺杂的低电阻率 膜中的低.因为大量硼原子进入到金刚石中后,可能 引起复杂的变化,带来各种缺陷<sup>[12]</sup>,并且空位在一 定情况下会发生扩散<sup>[13]</sup>,这些因素会对正电子的湮 没产生影响.同时,硼原子的半径较小,对正电子的 俘获能力较弱,但由于它们也会被吸引到缺陷中 去<sup>[14]</sup>,因此正电子在缺陷处的湮没会受到薄膜中硼 杂质的影响.

在所测的几个样品中,掺硫膜的 *S* 值最大.硫 在金刚石中可以提供电子,可能使得其附近的空位 带负电,进而这些空位很容易被正电子检测出<sup>[15]</sup>; 并且硫原子的半径也比较大,在有大尺寸杂质团存 在的地方,湮没参数会受到显著的影响<sup>2]</sup> 这些因素 都可能使得掺硫膜的 *S* 值增大.另外,本征金刚石 膜和掺硫金刚石膜是利用苯作为碳源制备得到的. 早期的研究表明<sup>16]</sup>,在金刚石薄膜的生长过程中, 氧可以去除反应中多余的碳原子,并且氢氧根和氧 原子在等离子体中与 sp<sup>2</sup> 物质的反应远比氢容易, 所以氧具有去除 sp<sup>2</sup> 杂质,获得纯的 CVD 晶粒和加 快反应速度的作用.因此用丙酮制备的金刚石膜可 能比用苯为碳源得到的膜中的缺陷少,这也可能是 掺硼膜中的 *S* 值比本征膜和掺硫膜的 *S* 值小的原 因之一.EPR 测试进一步证实了这一结果.电子顺磁 共振谱线的线宽  $\Delta H_{pp}$ 可以反映薄膜的晶格完整性, 窄的线宽表示晶格质量好<sup>[8]</sup>.比较表 2 中各样品的  $\Delta H_{pp}$ 值,本征金刚石薄膜和掺硫金刚石薄膜的  $\Delta H_{pp}$ 值比掺硼的金刚石薄膜的  $\Delta H_{pp}$ 值大,表明硼掺杂薄 膜的质量更好.

图 1( a)和( b)反映了缺陷增多使 S 增大,翼参 数 W 下降这一规律.图 1 中,正电子注入能量约为 4keV 时,各样品的 S 值基本达到定值,此时正电子 已经从薄膜表面进入到体结构中.本征金刚石膜的 S 值在约 9keV 时达到最大值,然后逐渐减小为 1, 说明正电子开始由金刚石膜逐渐过渡到硅衬底.对 于掺硼样品(100 $\Omega$ ·cm),正电子注入能量约为 15keV 时,S 值开始向 1 下降,正电子经历过渡层达到硅表 面;而掺硼膜(40 $\Omega$ ·cm)和掺硫膜在所研究的正电子 注入能量范围内还没有下降趋势,表明这两块薄膜 更厚,与表 1 列出的各样品的厚度是一致的.厚度差 异也可以从图 2 中 S 值和 W 值与正电子注入深度 之间的关系看出.正电子注入深度是与正电子注入 能量相对应的,本实验条件下,正电子注入深度与能 量之间满足关系

$$x = \frac{AE^n}{\rho} , \qquad (1)$$

其中 A = 40, n = 1.6 为常数, E 为注入正电子的能 量,  $\rho$  为样品的密度  $\Pi 2.3$  g/cm<sup>3</sup>, x 为注入深度, 单 位为 nm.从图  $\chi$  a) (b)可以看出, x < 10nm 时, 各样 品的 S 值和 W 值相差不大,此时正电子的注入深度 对应的能量低于 1keV. 能量低于 1keV 时测得的 S值受热化前能达到薄膜表面的正电子数目的影 响<sup>[17]</sup>,所以没有热化而能达到各样品表面的正电子 数目相差不大.当正电子入射深度增加,正电子达到 薄膜内部,与薄膜中缺陷的相互作用使得各样品的 S 值和 W 值发生了变化.

*S*-*W* 曲线的形状对于判断湮没正电子的缺陷种 类是很有用的<sup>[2,6]</sup>.如果 *S*-*W* 曲线为直线,说明样品 中湮没正电子的缺陷是同一种类型的.图 3 中,各样 品的 *S*-*W* 曲线除未掺杂金刚石膜外,其他基本为直 线.分析未掺杂金刚石膜的 *S*-*W* 曲线,有些点不在 直线上,这些点正好对应了过渡层中的 *S* 和 *W* 值, 说明过渡层中可能存在与金刚石薄膜中不同种类的

#### 缺陷湮没了正电子.

图 1(a)(b)中,当 4keV≤E≤16keV时,S和W 值反应了正电子在金刚石薄膜中的湮没,所以取图 3中各样品在正电子能量为 4 keV 和 8 keV 时的 S 和 W 值来作 S-W 曲线,可以避开衬底的影响,由图 4 可 以看出,S-W曲线满足很好的线性关系.根据文献 [2 和 6] 当正电子被同一种俘获中心俘获时 理想 情况下 ,S-W 曲线应该呈直线,图 4 的线性关系说明 了不同杂质元素掺杂后得到的金刚石膜中使正电子 湮没的缺陷种类是相同的 ,金刚石中的杂质种类不 同并不影响正电子的湮没特性:也说明正电子与不 同的杂质元素硼、硫之间的相互作用不明显,这与 Shiryaev 等人<sup>[6]</sup>对含氮金刚石的研究结果相似,他们 也发现正电子与氮杂质的相互作用不是很明显.另 外 图 4 的左上方 对应了小的 S 值和大的 W 值 表 明掺硼的金刚石膜的质量比硫掺杂和本征金刚石膜 的好<sup>[6]</sup>,与我们的 EPR 测试结果一致.

一般情况下,天然金刚石和高温高压合成的金 刚石的 g 因子在 2.0025—2.0030 之间<sup>[8]</sup>,多晶金刚 石的 g 因子为 2.0028 , $\Delta H_{pp}$ 约为 6 × 10<sup>-4</sup> T ,EPR 信 号来自于碳的悬键<sup>[18]</sup>.非晶区和无序区的 EPR 信号 表现为各向同性谱线,并且 g = 2.0025<sup>[19]</sup>,相似的 EPR 信号在利用溅射石墨得到的非晶碳膜样品中也 可观察到<sup>[20]</sup>.从表 2 可知,几个样品的 g 因子在 2.0025—2.0029 之间,与非晶碳膜的 g 因子比较,表 明样品中的 EPR 信号来自于碳的悬键,可能与空位 相关的缺陷或者与氢原子引起的悬键有关<sup>[21]</sup>,而不 是非晶金刚石中的悬键.另外, $\Delta H_{pp}$ 的值在 3.4— 5.5 × 10<sup>-4</sup> T 范围,小于非晶碳膜的线宽~8 × 10<sup>-4</sup> T<sup>[20]</sup>,也表明 EPR 信号主要是来自于点缺陷,即金刚 石的碳悬键<sup>[22]</sup>.

### 4.结 论

利用多普勒增宽谱和电子顺磁共振研究了未掺 杂、掺硼和掺硫金刚石薄膜的缺陷状态.多普勒增宽 谱的结果表明,对于不同杂质元素掺杂的金刚石薄 膜,其中使正电子湮没的缺陷种类是相同的;正电子 与不同杂质元素硼、硫之间的相互作用不明显;少量 硼可使金刚石膜中的空位浓度减小.EPR 结果表明, 掺杂样品的顺磁信号主要来自于金刚石的碳悬键, 薄膜中非晶碳相很少.

- [1] Ma R Z and Xu Z X 1997 The study method of material physics
  (Beijing: Metallurgy Industry Press) p52(in Chinese)[马如璋、
  徐祖雄 1997 材料物理现代研究方法(北京:冶金工业出版
  社)第 52页]
- [2] Hautojarvi P 1979 Positron in solids (Springer-Verlag) p12
- [3] Dannefaer S 1995 Appl. Phys. A 61 59
- [4] Dannefaer S , Zhu W , Bretagnon T and Kerr D 1996 Phys. Rev. B 53 1979
- [5] Pu A, Bretagnon T, Kerr D and Dannefaer S 2000 Diamond Relat. Mater. 9 1450
- [6] Shiryaev A A, van Veen A, Schut H and Kruseman A C 2000 Radiat. Phys. Chem. 58 625
- [7] Wang F H and Wu Z Q 1990 Experiments of solid-state physics
   (Beijing : Higher Education Press) p240(in Chinese)[王馥华、吴 自勤 1990 固体物理实验(高等教育出版社)第 240页]
- [8] Singh B P , Gupta S K , Dhawan U and Lal K 1990 J. Mater. Sci.
   25 1886
- [9] Poole C P 1983 Electron spin resonance (New York : A Wiley-Interscience Publication ) p459
- [10] Fabis P M 1998 Appl. Surf. Sci. 126 309
- [11] Show Y, Matsukawa T, Ito H and Iwase M 2000 Diamond Relat. Mater. 9 337

- [12] Tsubota T, Fukui T, Saito T, Kusakabe K, Morooka S and Maeda H 2000 Diamond Relat. Mater. 9 1362
- [13] Hu X J, Dai Y B, He X C, Shen H S and Li R B 2000 Acta Phys. Sin. 51 1388 (in Chinese)[胡晓君、戴永兵、何贤昶、沈荷生、 李荣斌 2000 物理学报 51 1388]
- [14] Thrane N and Evans J H 1977 Appl. Phys. 12 183
- [15] He Y J, Ma X K, Gui Z L and Li L T 1998 Acta Phys. Sin. 47 146 (in Chinese)[何元金、马兴坤、桂治轮、李龙土 1998 物理 学报 47 146]
- [16] Rebuli D B et al 1999 Diamond Relat. Mater. 8 1620
- [ 17 ] Wissmann B D, Gidley D W and Frieze W E 1992 Phys. Rev. B 46 16058
- [18] Zhou X, Watkins G D, Mcnamara Rutledge K M, Messmer R P and Chawla S 1996 Phys. Rev. B 54 7881
- [19] Brosious P R , Corbett J W and Bourgoin J C 1974 Phys. Sta. Sol.
   (a) 21 677
- [20] Dasgupta D, Demichelis F, Pirri C F and Tagliaferro A 1991 Phys. Rev. B 43 2131
- [21] Fanciulli M and Moustakas T D 1992 Diamond Relat . Mater . 1 773
- [22] Isoya J, Kanda H, Sakaguchi I, Morita Y and Ohshima T 1997 Radiat. Phys. Chem. 50 321

# Investigation of defect properties in doped diamond films \*

Hu Xiao-Jun<sup>1)†</sup> Li Rong-Bin<sup>1</sup>) Shen He-Sheng<sup>1</sup>) He Xian-Chang<sup>1</sup>) Deng Wen<sup>2</sup>) Luo Li-Xiong<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup>(State Key Laboratory of MMCM 'S, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200030, China)

<sup>2</sup> (Department of Physics, Guangxi University, Nanning 530004, China)

(Received 13 June 2003; revised manuscript received 24 September 2003)

#### Abstract

The defect properties in chemical vapor deposition diamond films doped by sulfur and boron were investigated by the Doppler broadening measurements and electron paramagnetic resonance (EPR). The results show that the defects annihilating the positrons is almost the same in various doped films, and the interactions between the dopants and the positrons are not distinct. In addition, a small amount of boron atoms can improve the quality of diamond films. The EPR signals of the diamond films arise from carbon dangling bonds.

Keywords : diamond , doping , Doppler broadening measurements , EPR PACC : 8120V , 6170T , 7870B , 6116N

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 50082005).

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> E-mail : huyezi@163.net ,Tel 1021-62933163.